

株式会社東京精密 2023年度(2024年3月期) 決算説明会
質疑応答 要約

2024年5月10日 開催

- 本資料は、上記日時に開催された2023年度(2024年3月期) 決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
 - 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
 - なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。
1. **1-3月期のSPE受注高は、社内想定を上振れたとのことだが、その要因と、生成AI関連受注の実績を伺いたい。**
 - 1-3月期のSPE受注高の上振れは、ロジック/HBM等、生成AI関連の受注(1-3月期で60億円程度、下期想定60-70億円に対し80億円程度)、ならびに中国の受注が想定以上であったことによる。
 - 2023年下期の生成AI受注構成は、ロジック/HBMで1:2程度の割合。
 - なお1-3月期の生成AI関連売上高は50億円半ば。
 2. **1-3月期の計測受注高が社内想定並みも、10-12月比で減少している背景は。**
 - 2024年に一部の製品の価格改定を行った。このため10-12月期に駆け込み受注が発生し、その反動減が出た。半期単位では大きな変化は無い。
 3. **1-3月期の営業利益率に関する評価を頂きたい。**
 - 1-3月期の売上高は四半期既往ピークを更新している。この売上高であれば、この利益率は出せるものと評価している。
 4. **1-3月期のSPE受注取消処理状況を聞きたい。**
 - 当社は4半期毎に受注残高を精査し、必要に応じて社内取消処理を行っている。1-3月期の取消処理は13億円程度となった。
 5. **1-3月期のSPE消耗品動向について伺いたい。**
 - ダイシングブレードは、携帯電話などの電子部品向けに、比較的大口の受注を獲

得している。生産数量確約の必要があるため、生産キャパシティを3倍にするための設備投資を行う予定。

- グラインダ用の砥石は、SiC 向けを中心に増加傾向ではあるものの、中国では地場メーカの安価な消耗品の台頭により苦戦している。当社は、付加価値がある砥石の開発などを通じて対抗する所存。

6. 顧客サイトのプローバの稼働率に関する認識を聞きたい。

- 一概に述べるのは難しいが、スマートフォン関連顧客、NAND 等では 70%程度ではないかとみている。特に台湾での稼働率が芳しくない。一方で、HBM に関しては、設備投資を進めている状況であるから、ほぼ 100%近いと推察。

7. 会社は 2024 年度の業績予想開示を上期までに留めた。この背景を伺いたい。

- 上期の予想は「民生需要が回復しない前提」で策定している。
- とはいえ、2024 年度上期の SPE は、最低でも 2023 年度下期と同等以上の事業環境にはなると考える。更に、2024 年下期に向けてよくなっていくと予想している。
- この1年、AI(AI ロジック/HBM)、SiC、CIS、中国マーケットが下支えする状況が続いた。民生についても、足許では、スマートフォン関連の引合に動意が出てきている。
- しかし、下期の業容がどこまでよくなるのかを現時点で定量的に見積もることは困難なので、上期までの予想開示に留めた。

8. 2024 年度上期業績予想において、SiC の需要を 2023 年下期比で倍増との前提を置く背景を聞きたい。

- パワー半導体全般の需要は軟調と認識。ただし SiC の投資に限っては、将来の需要を見越して続行されている。
- そんななか、今までの SiC は基板加工向けの需要だったが、足許の需要はデバイス加工後の対応にシフトしつつある。例えば平面加工では、デバイス向けは基板向けに比べて3倍の厚みを研削する必要があるため、当社の高剛性研削盤や CMP の事業機会となっている。デバイス向けでは更に、プローバ、ダイサの需要が加わってくる。このため、上期の受注高は 2023 年下期で倍増を想定している。
- なお、売上高は、(出荷納期の関係から) 減少を想定している。

9. 2024 年度上期業績予想における生成 AI 関連需要の考え方、市場前提を伺いたい。

- 上期も、2023 年度下期と同水準の受注環境を想定しているが、顧客の発注タイミ

ング(月単位での発注を行う)の関係で、上期後半の案件の期ずれリスクを考慮し、想定規模の半分程度のみ上期業績予想に織り込んでいる。

- なお、生成 AI 関連受注の構成比想定は、2023 年度下期と概ね同じ。
- また、上期で生成 AI 関連の引合が一段落するようなことは想定していない。

10. 2024 年度上期 SPE 業績予想における中国売上比率の見通しを聞きたい。

- 現在は全体の 40-45%で、2024 年度上期も高止まりすると想定。

11. 2024 年度上期 SPE 業績予想における受注残高の見通しを聞きたい。

- 計画通り推移すれば受注残高は減少する。あとは受注高次第となる。

12. 先ごろ、メモリパッケージの厚みの規格変更などが合意され、これによって Hybrid Bonding のメモリ製造プロセスへの展開が遅れるとの見方がある。これを踏まえ、Hybrid Bonding に関する現況や事業機会、今後の収益貢献の見込みなどについて伺いたい。

- 現時点では、次世代のデバイス開発のため、多くの顧客に対して Hybrid Bonding 向けにハイエンドグラインダの評価機を納入している。
- このグラインダは、当社が SiC 向けに開発した高剛性研削盤の技術を展開したもので、シリコンの研削でも高い平面均一精度ならびに高スループットを実現する。
- さらに、前工程の生産ラインへ納入されるため、前工程で必要な洗浄技術を、同じく展開中の CMP 製品の洗浄機能を用いることで達成している。このため、Hybrid Bonding 用グラインダの販売価格は、従来製品比で高価なものとなる。
- 当社は、2025 年後半~2026 年前半に Hybrid Bonding が量産展開するものと想定しており、それは NAND 向けで最初に展開されるものと想定している。その後、ロジックや HBM へ展開されると想定している。
- その需要は非常に大きいと考えており、グラインダでは、10 台/月以上の出荷規模になり得る。そのため、グラインダ増産のため、名古屋工場の建設に着手している。
- 名古屋工場は 2025 年上期の竣工を予定しており、これは説明資料に示す SPE 生産キャパシティ(2023 年度で 1,400 億円 + α を達成)の更に先のキャパシティを見据えたものである。
- 想定市場規模を考えると、これで十分とは考えておらず、すでに名古屋工場の次の工場を検討する段階に入っている。

13. 2024 年度上期業績予想における 為替影響の見通しを聞きたい。

- 2024 年度上期業績予想の為替前提は 1 ドル=145 円であるが、2023 年度実績に基づき、1 ドル 1 円の変動で 50 百万円程度の利益影響(円安がプラス)となった。なお、外貨建売上高の減少により為替影響は小さくなっている。

14. 計測 充放電試験システム事業の現況、今後の見通しを聞きたい。

- 充放電評価システム事業は、2023 年度に黒字化を達成。
- 足許では EV 用バッテリー開発が本格化し、当該システムの需要がますます増加しており、2024 年度の売上高は、前年比 2-3 割増を目指している。
- 今後 3 か年で、機器販売と受託測定ビジネスの両面で業容を拡大させ、売上高は 2023 年度比で 3 倍程度、利益率は、他計測製品と同水準を目指したい。

15. 3 か年中期経営計画の定量目標の達成は難しいとの理解か。

- まだ諦めていない。2023 年初夏までに民生関連受注が回復すれば、キャパシティを大幅に拡大させた現在、達成の可能性はある。定量目標の達成が 2024 年度下期から 2025 年度上期に延伸する可能性はあるが、達成を目指したい。
- そのうえで、生産稼働率が上昇すれば、定量目標として示す営業利益率 22%は達成できると考えるし、業容の拡大につれ、さらに上の利益率を目指すことも可能と考えている。

以上